

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2022 年 7 月 28 日 (28.07.2022)



(10) 国际公布号
WO 2022/156133 A1

(51) 国际专利分类号:
H01L 23/498 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2021/100847

(22) 国际申请日: 2021 年 6 月 18 日 (18.06.2021)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202110082929.3 2021 年 1 月 21 日 (21.01.2021) CN

(71) 申请人: 长鑫存储技术有限公司 (CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES, INC.) [CN/CN]; 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号, Anhui 230601 (CN)。

(72) 发明人: 卢宗正 (LU, Zongzheng); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号, Anhui 230000 (CN)。

(74) 代理人: 广州华进联合专利商标代理有限公司 (ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE); 中国

广东省广州市天河区珠江东路6号4501房
(部位: 自编01-03和08-12单元) (仅限办公用途), Guangdong 510623 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,

(54) Title: PACKAGE SUBSTRATE AND PACKAGE STRUCTURE

(54) 发明名称: 封装基板以及封装结构

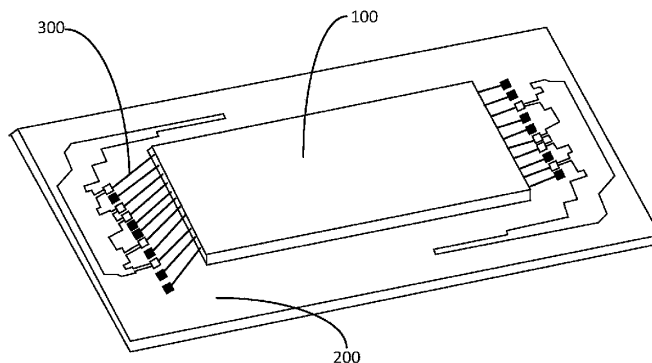


图 1

(57) Abstract: The present application relates to a package substrate and a package structure. The package substrate comprises: a first conductive layer, located at the top of a base and comprising power lines and signal lines, wherein the power lines are used for supplying power to a chip, and the signal lines are used for providing signals for the chip; and a second conductive layer, located at the bottom of the base and comprising first pads and local interconnection lines, wherein the first pads are electrically connected to the signal lines, and the plurality of associated first pads are electrically connected by means of the local interconnection lines.

(57) 摘要: 本申请涉及一种封装基板以及封装结构。其中, 封装基板包括: 第一导电层, 位于基底的顶部, 包括电源线以及信号线, 电源线用于为芯片供电, 信号线用于为芯片提供信号; 第二导电层, 位于基底的底部, 包括第一焊盘以及局部互连线, 第一焊盘与信号线电连接, 多个相关联的第一焊盘通过局部互连线电连接。

[见续页]

WO 2022/156133 A1

IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。